

2023年08月30日

广立微（301095.SZ）

聚焦成品率提升软硬件，加码研发提升技术壁垒

投资要点

2023年8月28日，公司发布2023年半年度业绩报告。2023年H1公司营业收入为1.27亿元，同比增长63.91%，归母净利润为0.23亿元，同比增长3903.60%；毛利率为62.32%，净利率为17.93%。

◆ **业务拆分：（1）软件开发及授权业务：**2023H1，软件开发及授权业务营业收入为0.32亿元，同比增长16.20%，毛利率为95.50%。①软件工具授权业务占比68.94%，同比增长57.77%，保持较快增长。②软件技术开发业务受外部贸易环境变化影响，近期客户先进工艺平台开发需求有所减缓，导致该类业务同比略有减少，但随着公司量产监控方案推广及客户端工艺制程推进，该项业务有望恢复增长。**（2）测试设备及配件：**2023H1，测试设备及配件业务营业收入为0.95亿元，同比增长78.35%，毛利率为50.95%。

◆ **专注成品率提升领域，持续加码研发投入提升技术护城河。**自成立以来，公司专注于集成电路成品率提升领域，自主研发包括 Addressable Solution（可寻址测试芯片方案）、超高密度测试芯片设计与芯片快速测试技术、Fast Parametric Testing Solution（快速电性参数测试解决方案）在内一系列核心技术，有效填补国内该技术领域空白。截至2023年6月30日，公司共拥有已授权专利116项，其中发明专利54项（包含美国专利11项），软件著作权92项。为确保自身核心竞争力及持续创新能力，公司保持持续高比例研发投入，2023H1，公司研发费用额为0.93亿元，占营业收入73.12%，同比增长98.72%。

◆ **聚焦制造类EDA迭代研发多功能模块，AI赋能数据分析加速产品成熟。**23H1，公司积极深化测试芯片相关EDA软件产品技术研发，迭代出支持更多应用场景功能模块，亦拓展出先进工艺过程监控（PCM）方案，打通设计、测试及分析工具整合平台，提供高效率解决方案，支持高质量稳定量产；同时，不断拓展开发其他品类制造类EDA，依托于公司在该领域技术沉淀，积极响应芯片设计公司晶圆制造厂需求，自主研发DFM系列化学机械抛光工艺（Chemical Mechanical Polishing, CMP）建模工具CMP EXPLORER，解决集成电路设计、制造过程中CMP工艺行业痛点，保障芯片可制造性和良率；另一方面，在半导体数据软件上，通过融入相关人工智能（AI）技术巩固数据分析和管理系统技术优势并加速产品成熟，通过与下游客户深度合作持续开发新品类离线与在线数据软件。

◆ **T4000及T4100S系列WAT测试设备应用多测试场景，可满足不同晶圆厂测试需求。**（1）T4000系列：通用型WAT测试设备，适用于大部分WAT电性测试场景。可覆盖LOGIC、CIS、DRAM、SRAM、FLASH、BCD等产品测试需求，支持第三代化合物半导体（SiC/GaN）参数测试。该机型能够兼容搭载可靠性WLR，满足汽车电子、新能源等芯片对该方向大量测试需求。（2）T4100S系列：针对先进工艺中更繁杂多样测试要求，推出的并行测试设备，在特定环境下其测试效率有较大提升。在测试精度相当前提下，通过软硬件协同实现动态分组测试和更智能人

公司快报

电子 | 半导体设备III

买入-A(维持)

投资评级

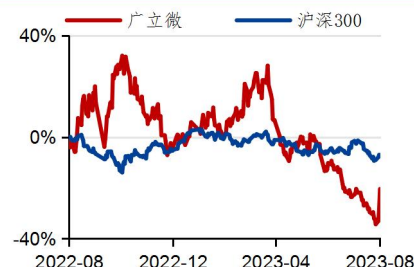
股价(2023-08-30)

73.24元

交易数据

总市值（百万元）	14,648.00
流通市值（百万元）	6,671.36
总股本（百万股）	200.00
流通股本（百万股）	91.09
12个月价格区间	117.50/62.46

一年股价表现



资料来源：聚源

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	9.02	-19.39	-12.71
绝对收益	3.9	-20.57	-20.07

分析师

孙远峰

 SAC执业证书编号：S0910522120001
 sunyuanfeng@huajinsc.cn

分析师

王海维

 SAC执业证书编号：S0910523020005
 wanghaiwei@huajinsc.cn

相关报告

广立微：软硬件协同优势凸显，业务闭环巩固技术壁垒-广立微业绩点评 2023.3.30



机交互等功能，测试效率更高。该系列机型在产业化系统整合和测试标准上更具优势，常被用于测试量较大且对测试效率要求较高的 12 寸晶圆厂。

- ◆ **投资建议：**我们维持盈利预测，预计公司 2023 年至 2025 年营业收入分别为 6.22/10.02/16.23 亿元，增速分别为 75.0%/61.0%/62.0%；归母净利润分别为 1.92/2.91/5.13 亿元，增速分别为 56.9%/51.3%/76.4%；对应 PE 分别 76.3/50.4/28.6。为考虑到公司在成品率提升领域提供全流程软硬件生态稀缺性，叠加新建晶圆厂浪潮及产能自给率有望提升等因素，将为成品率提升领域提供广阔市场空间，为公司未来业绩增长夯实基础，维持买入-A 建议。
- ◆ **风险提示：**半导体行业景气度低于预期；新建晶圆厂进度不及预期；公司研发进程不及预期。

财务数据与估值

会计年度	2021A	2022A	2023E	2024E	2025E
营业收入(百万元)	198	356	622	1,002	1,623
YoY(%)	59.9	79.5	75.0	61.0	62.0
净利润(百万元)	64	122	192	291	513
YoY(%)	27.8	92.0	56.9	51.3	76.4
毛利率(%)	76.5	67.8	69.1	70.4	72.2
EPS(摊薄/元)	0.32	0.61	0.96	1.45	2.56
ROE(%)	17.6	3.8	5.8	8.1	12.6
P/E(倍)	229.8	119.7	76.3	50.4	28.6
P/B(倍)	40.3	4.6	4.4	4.1	3.6
净利率(%)	32.2	34.4	30.8	29.0	31.6

数据来源：聚源、华金证券研究所

财务报表预测和估值数据汇总

资产负债表(百万元)

会计年度	2021A	2022A	2023E	2024E	2025E
流动资产	358	3278	3336	3749	4212
现金	172	2944	2791	2924	2892
应收票据及应收账款	113	176	330	485	835
预付账款	0	1	1	2	3
存货	60	138	194	317	462
其他流动资产	13	20	20	20	21
非流动资产	74	234	267	323	420
长期投资	0	0	0	0	0
固定资产	41	62	94	147	236
无形资产	0	1	0	0	1
其他非流动资产	32	170	173	176	183
资产总计	432	3512	3603	4072	4632
流动负债	61	255	246	455	535
短期借款	0	0	0	0	0
应付票据及应付账款	20	45	64	103	151
其他流动负债	41	211	182	352	384
非流动负债	8	71	60	51	43
长期借款	0	61	50	40	33
其他非流动负债	8	10	10	10	10
负债合计	69	326	306	505	579
少数股东权益	0	0	-1	-1	-2
股本	150	200	200	200	200
资本公积	120	2770	2770	2770	2770
留存收益	93	215	375	606	987
归属母公司股东权益	363	3186	3298	3568	4056
负债和股东权益	432	3512	3603	4072	4632

现金流量表(百万元)

会计年度	2021A	2022A	2023E	2024E	2025E
经营活动现金流	8	199	-78	202	129
净利润	64	122	191	290	512
折旧摊销	8	19	12	18	28
财务费用	-5	-39	-55	-34	7
投资损失	0	-1	-0	-0	-0
营运资金变动	-84	36	-226	-72	-417
其他经营现金流	26	62	0	0	0
投资活动现金流	-48	-169	-45	-73	-124
筹资活动现金流	-8	2729	-30	5	-38

每股指标(元)

每股收益(最新摊薄)	0.32	0.61	0.96	1.45	2.56
每股经营现金流(最新摊薄)	0.04	1.00	-0.39	1.01	0.64
每股净资产(最新摊薄)	1.82	15.93	16.49	17.84	20.28

利润表(百万元)

会计年度	2021A	2022A	2023E	2024E	2025E
营业收入	198	356	622	1002	1623
营业成本	47	115	192	296	451
营业税金及附加	1	3	3	5	9
营业费用	19	30	50	70	89
管理费用	18	26	44	60	81
研发费用	65	124	199	311	454
财务费用	-5	-39	-55	-34	7
资产减值损失	-1	-2	-3	-5	-7
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
投资净收益	0	1	0	0	0
营业利润	69	130	204	309	545
营业外收入	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0
利润总额	68	130	204	309	545
所得税	5	7	13	19	33
税后利润	64	122	191	290	512
少数股东损益	0	0	-1	-1	-1
归属母公司净利润	64	122	192	291	513
EBITDA	71	64	132	243	487

主要财务比率

会计年度	2021A	2022A	2023E	2024E	2025E
成长能力					
营业收入(%)	59.9	79.5	75.0	61.0	62.0
营业利润(%)	27.6	89.1	57.1	51.5	76.3
归属于母公司净利润(%)	27.8	92.0	56.9	51.3	76.4
获利能力					
毛利率(%)	76.5	67.8	69.1	70.4	72.2
净利率(%)	32.2	34.4	30.8	29.0	31.6
ROE(%)	17.6	3.8	5.8	8.1	12.6
ROIC(%)	16.0	1.3	3.3	5.8	10.5
偿债能力					
资产负债率(%)	15.9	9.3	8.5	12.4	12.5
流动比率	5.9	12.8	13.6	8.2	7.9
速动比率	4.7	12.2	12.7	7.5	7.0
营运能力					
总资产周转率	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4
应收账款周转率	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5
应付账款周转率	3.8	3.6	3.6	3.6	3.6
估值比率					
P/E	229.8	119.7	76.3	50.4	28.6
P/B	40.3	4.6	4.4	4.1	3.6
EV/EBITDA	204.5	184.5	90.6	48.6	24.3

资料来源：聚源、华金证券研究所

公司评级体系

收益评级：

买入—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上；

增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%；

中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%；

卖出—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

孙远峰、王海维声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址： www.huajinsec.cn